Unidades De estado solido

Dispositivos de Almacenamiento con Celdas de Memoria:

Funcionamiento, Diseños y Evolución

Desde MMC hasta SSD NVMe

Ventajas comparacion Desventaja

Desventajas # Evolucion







Introducción a los Dispositivos de Almacenamiento con Celdas de Memoria

Los dispositivos de almacenamiento con celdas de memoria son sistemas que utilizan tecnología de memoria flash para almacenar datos de forma no volátil, manteniendo la información incluso sin alimentación eléctrica.

Estos dispositivos han revolucionado el almacenamiento digital, ofreciendo mayor velocidad, durabilidad y eficiencia energética en comparación con los sistemas tradicionales.

Principales Aplicaciones





Funcionamiento de las Celdas de Memoria

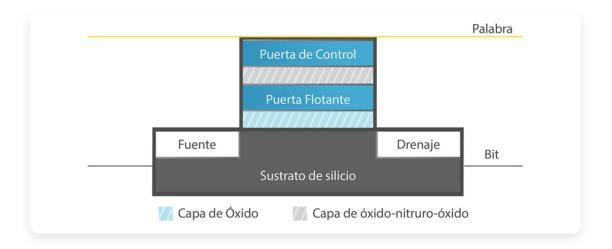
Estructura Básica

- Transistor de puerta flotante: componente fundamental
- Puerta de control, puerta flotante aislada y canal de conducción
- La puerta flotante almacena carga eléctrica de forma aislada

Almacenamiento de Datos

- Presencia de carga = estado lógico "0"
- Ausencia de carga = estado lógico "1"
- La carga modifica la tensión umbral del transistor

La clave del funcionamiento es la capacidad de retener carga eléctrica en la puerta flotante de forma estable, lo que permite la memoria no volátil.



Estructura de un transistor de puerta flotante en memoria flash

Operaciones Básicas

- Lectura: medir conductividad del transistor
- Escritura: inyectar electrones en puerta flotante
- Borrado: eliminar electrones de puerta flotante

Materiales Utilizados en la Fabricación de Celdas de Memoria Flash

A Componentes Principales

E Semiconductores

Silicio (Si) como material base para transistores

4 Conductores

Polisilicio y metales para interconexiones

Aislantes

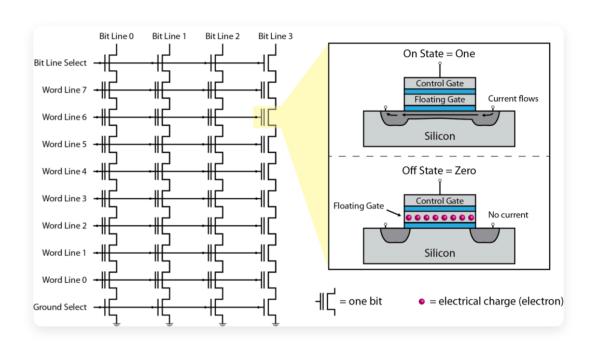
Óxido de silicio (SiO₂) para aislar la puerta flotante

▲ Materiales Avanzados

Nitruro de silicio (SiNx) para memristores

La evolución de los materiales ha permitido aumentar la densidad de almacenamiento y mejorar el rendimiento de las celdas de memoria.

- Reducción del tamaño de las celdas (miniaturización)
- Mayor número de bits por celda (MLC, TLC, QLC)
- Mejora en la retención de datos y durabilidad



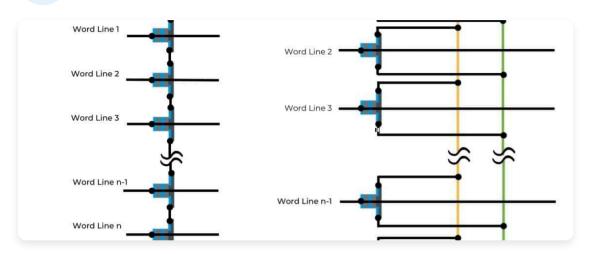
Estructura física de las celdas de memoria flash mostrando cortes transversales

Estructura Física

- **Substrato**: base de silicio donde se construyen los transistores
- Canal: región donde fluyen los electrones
- Puerta flotante: capa aislada que almacena carga eléctrica
- Puerta de control: permite controlar el flujo de electrones

Diseños de Memoria: NAND vs NOR

Memoria NAND



- ⇔ Celdas conectadas en **serie**
- Mayor densidad de almacenamiento
- Escritura y borrado más rápidos
- \$ Menor coste por bit

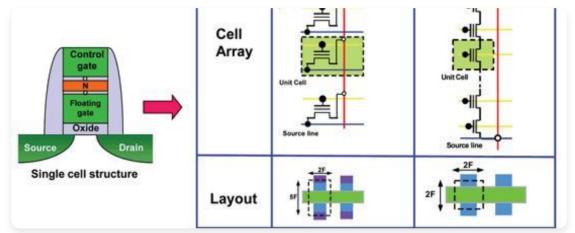


SSD Tarjetas SD

USB

Almacenamiento masivo

■ Memoria NOR



- [↑] Celdas conectadas en **paralelo**
- Lectura aleatoria rápida
- Escritura a nivel de byte individual
- Mayor fiabilidad

Aplicaciones

BIO.

Firmware

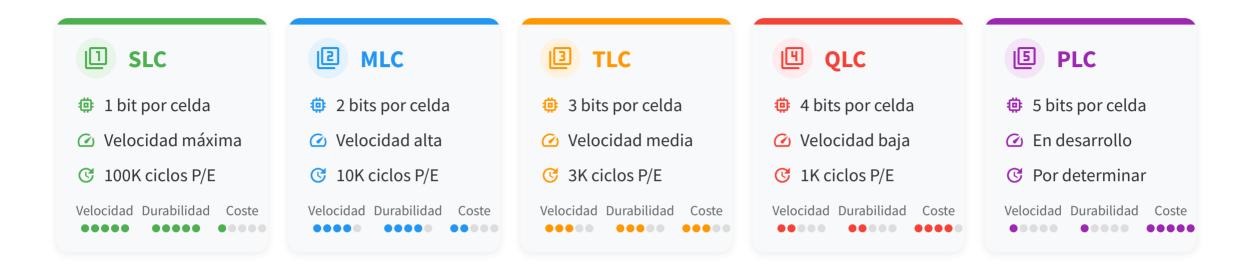
Sistemas embebidos

Código de programa

Comparativa Rendimiento

Característica	NAND	NOR
Velocidad de escritura	Alta	Ваја
Velocidad de lectura	Media	Alta
Durabilidad (ciclos P/E)	10K-100K	100K-1M

Tipos de Memoria según Bits por Celda



Relación entre Densidad y Rendimiento



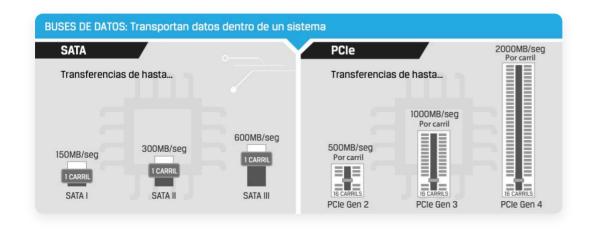
- Mayor densidad (más bits por celda) = menor rendimiento y durabilidad
- Menor densidad (menos bits por celda) = mayor velocidad y vida útil
- Compensación entre capacidad, velocidad, durabilidad y coste

Interfaces de Acceso: SATA vs PCIe vs NVMe









- → Ventajas Clave de NVMe
- Hasta 24 veces más rápido que SATA III
- Menor latencia gracias a ruta de datos optimizada
- Gestión eficiente de colas reduce carga de CPU

Problemas de Temperatura y Durabilidad

d Efectos de la Temperatura

- Altas temperaturas degradan las celdas NAND
- Pérdida de carga eléctrica en la puerta flotante
- Aumento de errores de bits (saltos de bits)
- Acorta significativamente la vida útildel dispositivo

G Métricas de Durabilidad



- SLC: 100,000 ciclos P/E (máxima durabilidad)
- QLC: 1,000 ciclos P/E (menor durabilidad)





SSD M.2 con disipador de calor para gestión térmica

A Señales de Problemas Térmicos

- Rendimiento reducido (hasta 2/3 menos)
- Errores frecuentes de lectura/escritura
- Dispositivo caliente al tacto
- Apagones inesperados

Recomendaciones

- Mantenerentorno operativo refrigerado
- Evitar exposición a calor excesivo
- Utilizar SSD condisipadores de calor
- Monitorear temperatura regularmente

Proceso de Escritura y Lectura de Datos

Escritura de Datos

- Aplicación de voltaje
 Se aplica un alto voltaje a la puerta de control del transistor
- Túnel Fowler-Nordheim

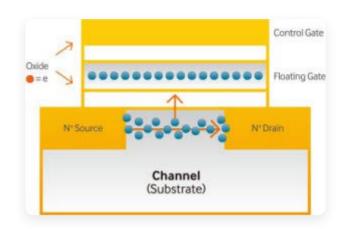
 Electrones atraviesan la capa de óxido mediante efecto túnel
- Almacenamiento de carga

 Electrones quedan atrapados en la puerta flotante,
 representando un "0"

• Lectura de Datos

- 1 Aplicación de voltaje
 Se aplica un voltaje específico a la puerta de control
- Medición de conductividad
 Se mide si el transistor conduce corriente
- Determinación del estado

 Conducción = "1" (sin carga), No conducción = "0" (con carga)

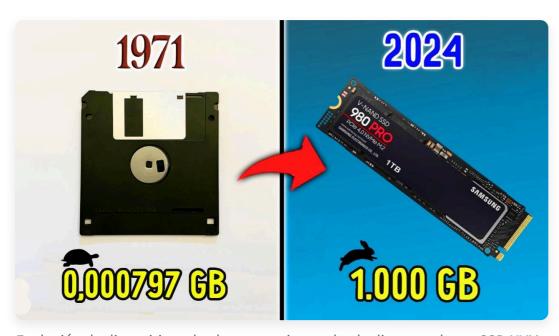


Estructura y principio de funcionamiento del transistor de puerta flotante

Borrado de Datos

- 1 Voltaje inverso Se aplica un voltaje inverso al utilizado en la escritura
- 2 Liberación de electrones
 Electrones abandonan la puerta flotante mediante efecto
 túnel
- Borrado en bloque
 El borrado se realiza en bloques completos, no celda por celda
 - Características Clave
- F El nombre "FLASH" proviene de la velocidad del borrado en bloque
- Los datos retenidos sin alimentación (memoria no volátil)
- Cada ciclo de escritura/borrado desgasta la celda

Evolución Histórica: desde MMC hasta SSD NVMe



Evolución de dispositivos de almacenamiento: desde disquetes hasta SSD NVMe

1987

• Invención de la memoria flash

Toshiba desarrolla el primer prototipo de memoria flash NAND

1997

Aparición del MMC

Siemens y SanDisk lanzan el MultiMediaCard (MMC), precursor de las tarjetas SD

2000

P Interfaces estandarizadas

Lanzamiento de SATA y popularización de las unidades USB

2009

SSD de consumo

Los SSD basados en NAND se vuelven asequibles para el mercado de consumo

2011

F NVMe

Aparece el protocolo NVMe, diseñado específicamente para SSD

2015+

→ 3D NAND y PCIe 4.0/5.0

Tecnología 3D NAND y nuevas generaciones de PCIe aumentan velocidad y capacidad



Capacidad

De MB a varios TB en un espacio reducido



Velocidad

De KB/s a más de 7.000 MB/s con NVMe



Fiabilidad

Mayor resistencia a golpes y vibraciones



Eficiencia

Menor consumo energético y menor calor